

SKC, CMP 패드 품질인증 획득

반도체 웨이퍼 평탄화 공정 독자개발 ... 세계시장 2500억원 “유망”

SKC가 반도체 웨이퍼 제조시 평탄화 공정에 사용되는 CMP(화학적기계연마) 패드를 독자적인 기술로 개발해 삼성전자로부터 품질인증을 받았다.

SKC는 품질 인증으로 반도체 소재사업부분으로 사업영역을 확대하게 됐다고 밝혔다.

CMP 패드는 반도체 웨이퍼의 표면을 평탄하게 만드는 연마제로 현재 세계시장이 약 2500억원 정도이며 2007년에는 6000억원으로 확대가 예상되는 유망산업으로 평가되고 있다.

SKC 관계자는 “삼성의 품질인증을 시작으로 4/4분기부터 매출과 생산능력을 늘려 안정적인 국내 매출기반을 조성하는 한편, 빠른 시간 안에 해외시장 진출을 목표로 사업을 추진하고 있다”고 밝혔다.

<화학저널 2004/10/15>